

# 苏州国芯科技股份有限公司

## 2024年3月6日至3月7日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	摩根士丹利基金；长盛基金；广发基金；易方达基金；东方基金；东方阿尔法基金；红塔红土基金；红土创新基金；信达澳亚基金；富荣基金；华商基金；中邮基金；创金合信基金；华泰柏瑞基金；国投瑞银基金；天弘基金；工银瑞信基金；银河基金；汇添富基金；广发证券；中信证券；五矿证券；国投证券；博时资本；深圳国源信达资本；深圳泽正私募；北京泰德圣私募；华美国际投资；中英人寿；大家资产；广发资管；杉树资产；金泰基金；鑫元基金；长城自营；鹤禧投资
时间	2024年3月6日9:00；2024年3月6日10:00；2024年3月6日11:45；2024年3月6日13:30； 2024年3月7日13:30；2024年3月7日14:30；2024年3月7日15:30
地点	深圳东海朗廷酒店会议室；广州香格里拉大酒店会议室
上市公司参加人员	证券事务代表：龚小刚先生

姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。投资者提问的问题主要如下：</p> <p><b>1、请问目前汽车电子 MCU 市场去库存情况如何？公司的汽车电子业务今年的是否有望进一步增长？</b></p> <p>答：从我们观察到的行业情况来看，目前汽车电子 MCU 芯片去库存正在加速进行，市场需求正在回暖，汽车电子 MCU 芯片的需求正在逐步提升。国产替代仍将是我国汽车电子芯片的市场趋势之一；同时，汽车的电动化、智能化、网联化发展趋势，国产新能源车渗透率进一步上升，国产品牌汽车出口量扩大等因素将共同推动汽车电子芯片需求的上涨。2024 年以来，公司陆续获得新的汽车电子芯片订单，特别是部分新的高端芯片已经开始批量销售，具体详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上发布的相关公告。</p> <p>2023 年，公司为大力发展汽车电子芯片，持续较大规模投入产品与技术研发，陆续推出了中高端汽车电子 MCU 芯片 CCFC3007PT 和 CCFC3008PT、汽车电子 PSI5 收发器专用芯片 CIP4100B、安全气囊点火驱动专用芯片 CCL1600B、汽车智能座舱音响和主动降噪 DSP 芯片 CCD5001 等新产品。公司今年还将有更多在研的高端 MCU、SoC 芯片推出面向市场，目前在研的重要产品包括多核高性能汽车电子 MCU（用于高端的动力控制和域控制等）CCFC3012PT、底盘驱动芯片 CCL2200B、智能传感芯片 CMA2100B、门控专用芯片 CCL1100B 芯片、无刷电机控制 CBC2100B 和 NFC 射频收发 CN7160 芯片等。值得一提的是，正在开发的 CCFC3009PT 芯片是面向汽车辅助驾驶</p>

	<p>和智能底盘领域应用而设计开发的高端 MCU 芯片，采用高性能 RSIC-V 架构（6 个主核+4 个锁步核），预计算力更高可达到 6000DMIPS 以上。</p> <p>公司的汽车电子芯片已进入比亚迪、奇瑞、上汽、长安、吉利、东风、一汽、长城、小鹏等著名自主品牌汽车，亦继续与埃泰克、易鼎丰、经纬恒润、科世达（上海）、奥易克斯和浙江埃创等 Tier1 模组厂商以及中电普华、东软睿驰、诚迈等操作系统软件厂商保持紧密合作，同时与潍柴动力等多家发动机厂商保持业务协同创新与合作。公司致力于通过持续的研发与创新，在汽车电子芯片领域推出更多芯片产品与解决方案，拓展出更广阔的市场空间，从而实现业务的增长。</p> <p><b>2、公司怎么考虑对域控芯片的布局，公司在这块有什么产品吗？</b></p> <p>答：域控已经成为车载 ECU 芯片的演进趋势，公司认为，未来区域控制器以及核心的主控处理器将朝着高性能、高异构性、高集成度、高安全性、高可靠性的方向发展。为了顺应域控制器以及核心的主控处理器的发展趋势，公司在汽车域控制芯片领域布局了中端域控制器芯片 CCFC2016BC，高端域控制芯片 CCFC3007PT、CCFC3008PT、CCFC3009PT 和 CCFC3012PT 系列，实现公司域控芯片的系列化，满足客户不同应用的需求。</p> <p>CCFC2016BC 是基于公司自主 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核研发的中端域控制芯片，该芯片基于 40nm eflash 工艺开发和生产，具备多种独立的汽车标准通讯接口 Flexline(14 路)、CAN_FD(8 路)以及对外控制接口 eMIOS (64 通道)、高效时序处理单元 eTPU</p>
--	--

(64 通道) 等, 芯片还配置了较大容量的存储空间, 具有高可靠性, 可以广泛应用于域控制器、整车控制、底盘控制、发动机控制以及电池管理 (BMS) 等。该芯片产品已在多个汽车电子领域实现应用。

CCFC3008PT 芯片是基于公司自主 PowerPC 架构 C\*Core CPU 内核研发的适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的高端多核 MCU 芯片, 是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。该芯片基于 40nm eFlash 工艺开发和生产, 内嵌 3 个运行频率达到 300MHz 的运算 CPU 核, 其中包括两个主核和一个锁步核, 另外还内嵌一个运行 200MHz 的控制 CPU 核; 该芯片内嵌一个硬件安全 HSM 模块, 支持 AES/Crypto/SM2 等国际和国密算法, 可以支持安全启动和 OTA。该芯片已获得量产订单。

CCFC3007PT 同样是基于公司自主 PowerPC 架构 C\*Core CPU 内核研发的更高端适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核 MCU 芯片, 相对于同系列的 CCFC3008PT 芯片, 通信 LIN 增加到 16 路、MCAN 增加到 12 路, 芯片的存储空间 Flash 容量增加到 12M 字节, 数据存储最高配置 Flash 最高可达 512K 字节, 内存空间 SRAM 增加到 1536K 字节。另外, 该芯片优化了 SDADC 模块及相应的数字滤波模块, 使其更适合电机控制, 还增加了 I2S (2 路) 用于连接音频设备。相对于同系列的 CCFC3008PT 芯片性能更加优越, 具备高可靠性和高安全性, 可以应用于苛刻的使用场景, 从而进一步增加了产品的应用覆盖面, 已在多个领域获得主机厂和发动机厂的定点选型, 主要包

括一汽、比亚迪、广汽、奇瑞、长安及潍柴集团等。其中在域控领域：典型的有埃泰克车身域控制器，某国际厂商的域控平台，某 XX 汽车研究院的位置域控制器等。

公司正在开发的 CCFC3012PT 芯片是基于 C\*Core 自主 PowerPC 架构内核研发的新一代适用于汽车电子高度集成的域控制器、ADAS 控制器、多电机控制等更高算力，更高信息安全以及更高功能安全等级应用需求的全新多核架构芯片。该芯片基于 40nm eFlash 工艺开发，总共有 10 个 300Mhz 的主核，其中 6 个主核，4 个是锁步核。芯片的存储空间 Flash 包含 16.5M 字节的程序 Flash，1M 字节的数据 Flash，内存空间 SRAM 达到 2.4M 字节。同时包含一个 SD/EMMC 接口可以外扩存储空间。车载网络接口包含一路 100/1000Mbps 的 TSN 以太网接口，12 路 lin 和 12 路 CANFD 总线接口以及 2 路 Flexray 接口。外部 Timer 接口包含 EMIOS 和 GTM 接口。另外含有 13 个 SARADC 和 14 个 SDADC 模块。封装形式包括 BGA516/BGA292 等，信息安全子系统满足 Evita-Full 标准同时支持国密算法。功能安全模块满足 ASIL-D 的功能安全等级。预计算力可达到 2700DMIPS 左右，具备高可靠性和高安全性，可以应用于高性能的使用场景，可对标英飞凌高端 TC397MCU 芯片应用。

同时公司和国内重大客户合作，紧密结合重大客户产品应用需求，还启动开发了 CCFC3009PT 芯片，这是面向汽车辅助驾驶和智能底盘领域应用而设计开发的高端 MCU 芯片，采用高性能 RSIC-V 架构（6 个主核+4 个锁步核），预计算力更高可达到 6000DMIPS 以上，是 CCFC3012PT 芯片的一倍，具有先进水平。

---

附件清单 (如有)	无
日期	2024年3月